公司代码:688820　　公司简称:盛合晶微

盛合晶微半导体有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司,公司治理制度需遵守《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定,与目前适用于注册在中国境内的一般A股上市公司的公司治理制度存在一定差异,但关于投资者权益保护的安排总体上不低于境内法律要求。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	盛合晶微	688820	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周燕	魏永利
电话	0510-86975899	0510-86975899
办公地址	江苏省江阴市东盛西路9号	江苏省江阴市东盛西路9号
电子信箱	IR@sjsemi.com	IR@sjsemi.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,477,432,397.19	22,603,487,460.17	21.56
归属于上市公司股东的净资产	19,293,023,996.47	14,427,851,311.79	33.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,406,831,397.09	3,177,996,180.51	7.20
利润总额	439,379,584.46	434,943,470.70	1.02
归属于上市公司股东的净利润	449,359,445.31	434,894,465.01	3.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,875,708.74	421,890,385.68	3.31
经营活动产生的现金流量净额	1,473,611,282.85	1,700,386,280.46	-13.34
加权平均净资产收益率(%)	2.80	3.14	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	-
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.26	-3.85
研发投入占营业收入的比例(%)	11.57	11.53	增加0.04个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	110,015
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江阴新国联创业投资有限公司-无锡产发科创基金合伙企业(有限合伙)	其他	9.39	175,000,000	175,000,000	175,000,000	无	0
上海玉旷科技合伙企业(有限合伙)	其他	5.88	109,600,000	109,600,000	109,600,000	无	0
深圳市远致创业投资有限公司-深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.30	98,666,666	98,666,666	98,666,666	无	0
上海芮嵘信息科技合伙企业(有限合伙)	其他	2.45	45,700,000	45,700,000	45,700,000	无	0
元禾厚望(苏州)私募基金管理有限公司-苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.28	42,400,000	42,400,000	42,400,000	无	0
中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙)	其他	2.23	41,522,377	41,522,377	41,522,377	无	0
Golden Link Worldwide Limited	境外法人	2.15	40,000,000	40,000,000	40,000,000	无	0
元禾厚望(苏州)私募基金管理有限公司-苏州元禾厚望长芯创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.15	40,000,000	40,000,000	40,000,000	无	0
上海金浦国际企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.09	39,000,000	39,000,000	39,000,000	无	0
元禾璞华阿芒(苏州)投资管理有限公司-苏州璞华创宇股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.02	37,666,666	37,666,666	37,666,666	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州元禾厚望长芯创业投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为元禾厚望(苏州)私募基金管理有限公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688820　证券简称:盛合晶微　公告编号:2026-019

盛合晶微半导体有限公司
关于《期权激励计划》部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股票期权可行权数量:截至2026年7月31日,期权激励计划上市后第一个行权期可行权数量为47,465,090份。

● 行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

盛合晶微半导体有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月19日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈期权激励计划〉部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的议案》,现将相关事项公告如下:

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)期权激励计划方案及履行的程序

公司于2015年1月由股东会审议通过了《SJ Semiconductor Corporation 2014 Stock Option Plan》,此后经历数次修订。其中,2023本3月,董事会作为执行管理机构,审议通过了用于上市后行权的期权的配套授予文件(下称“执行条款”),具体规范期权归属条件、行权安排与程序、行权条件及终止情形等实施细则;2024年4月,董事会审议通过了上市后行权的期权的业绩考核条件;2025年3月,股东会审议通过了第五次修订和重述的《SJ Semiconductor Corporation 2014 Stock Option Plan》(以下简称“期权激励计划”或“《期权激励计划》”,与执行条款合称“上市后行权的期权激励计划”),该计划规定了执行管理机构职权、计划有效期、激励对象、行权后持股方式等核心内容。

(二)历次股票期权授予情况

基于期权激励计划及执行条款,截至2025年6月30日,公司共计授出20,541.16万份期权,其中:8,311.64万份期权已通过直接持有公司股份或通过境内外持股平台间接持有公司股份的方式进行了落地行权(以下简称“已行权落地期权”);2,001.32万份期权因激励对象任职时间较短未满足归属条件、离职后未在约定期限内行权、放弃行权而失效等情形,使得该部分期权不具备可行权效力;10,228.20万份期权于上市后在符合行权条件的情况下进行行权(以下简称“上市后行权的期权”)。上市后行权的期权授予情况如下:

序号	项目	期权激励计划约定的内容
1	授予日期	激励对象在期权激励计划项下被授予相关期权之日,具体以激励对象与公司签署的期权授予文件约定日期为准
2	授予数量	102,282,027份
3	授予人数	636名
4	授予后股票期权剩余数量	0份
5	行权价格	具体于公司与每名激励对象签署的期权授予文件中确定(其行权价格介于每股0.36美元至1.20美元之间)

(三)行权数量和行权人数的调整情况

2026年8月19日,公司第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈期权激励计划〉部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的议案》,确认截至2026年7月31日,根据上市后行权的期权激励计划相关规定,合计58名激励对象因离职、第一个行权期个人业绩考核不达标、放弃行权等原因不得行权,共计4,481,720份期权失效并由公司注销。

本次注销完成后,截至2026年7月31日,公司上市后行权的期权总数为97,800,307份,第一个行权期内可行权的期权数量为47,465,090份,可行权激励对象人数共计578人。

(四)股票期权行权情况

公司上市前,共计8,311.64万份期权已落地行权,具体情况详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。截至本公告披露日,上市后行权的期权均未进行行权。

二、股票期权行权条件说明

(一)董事会就股权激励计划设定的股票期权行权条件是否成就的审议情况

2026年8月19日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈期权激励计划〉部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事均回避表决,董事会同意拟行权的578名激励对象的相关期权上市后第一个行权期行权条件已成就。

(二)薪酬与考核委员会意见

经审议,董事会薪酬与考核委员会认为:拟行权的578名激励对象的相关期权的上市后第一个行权期行权条件已成就,同意符合行权条件的578名激励对象在规定的行权期内行权,本次可行权数量为47,465,090份。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《期权激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意《关于公司〈期权激励计划〉部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的议案》,并同意提交公司董事会审议。

(三)本次激励对象行权是否符合股权激励计划规定的各项行权条件

依据期权激励计划及执行条款,上市后行权的期权共设置4个行权期,激励对象可在4个行权期内对已归属的期权行权,每个行权期为12个月,每次行权的期权份额不得超过其所持上市后行权的期权总额的50%。具体如下:

行权安排	行权时间
第一个行权期	自归属起始日起满12个月且公司完成上市后的次日起12个月内
第二个行权期	第一个行权期届满日后的12个月内
第三个行权期	第二个行权期届满日后的12个月内
第四个行权期	第三个行权期届满日后的12个月内

鉴于上市后行权的期权的归属起始日均在公司上市前12个月前,第一个行权期的起始日为公司首发上市之日的次日,公司已进入第一个行权期。相关法律、规范性文件及期权激励计划规定的行权条件及相应的成就情况如下:

	行权条件	成就情况
公司层面业绩考核指标	公司以营业收入增长率作为公司层面业绩考核指标,每个会计年度考核一次,各年度公司业绩考核目标如下: 行权期 公司层面业绩考核要求 第一个行权期 2023年度营业收入较2022年度增长率不低于50% 第二个行权期 2024年度营业收入较2022年度增长率不低于100% 第三个行权期 2025年度营业收入较2022年度增长率不低于150% 第四个行权期 2026年度营业收入较2022年度增长率不低于200% 公司层面未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象在对应行权期内当期可行权期权份额及当期拟行权期权份额将自动失效并由公司注销。	根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(容诚审字[2025][230Z5011号]):公司2023年度营业收入为30.38亿元,较2022年度增长率为86.10%,上市后行权的期权的第一个行权期公司层面业绩考核结果达到考核目标。
个人层面业绩考核指标	如激励对象个人在行权日前一年度的考评结果未达到“3-”,则该激励对象在对应行权期内当期可行权期权份额及当期拟行权期权份额将自动失效并由公司注销。	截至2026年7月31日,除57名离职员工外,参与本次考核的激励对象共579名,达成个人业绩考核指标的激励对象共578名。
公司未发生禁止事项	公司未发生以下任一情形: a.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; b.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; c.公司上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; d.法律法规规定不得实行股权激励的; e.中国证监会认定的其他情形。	截至本公告披露日,公司未发生期权激励计划及执行条款规定的前述禁止事项。
激励对象未发生禁止事项	激励对象未发生以下任一情形: a.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; b.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; c.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; d.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; e.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; f.中国证监会认定的其他情形。	截至本公告披露日,达成个人业绩考核指标的激励对象未发生期权激励计划及执行条款规定的前述禁止事项。

综上所述,公司期权激励计划上市后第一个行权期行权条件已成就,符合行权条件的激励对象为578名,本次可行权数量为47,465,090份。

(四)未达到行权条件的股票期权处理方法

期权因离职、第一个行权期个人业绩考核不达标、放弃行权导致不能行权的,期权失效并由公司予以注销。

三、本次行权的具体情况

(一)授予日:激励对象在期权激励计划项下被授予相关期权之日,具体以激励对象与公司签署的期权授予文件约定日期为准。

(二)可行权数量:47,465,090份。

(三)可行权人数:578人。

(四)行权价格:具体于公司与每名激励对象签署的期权授予文件中确定(其行权价格介乎每股0.36美元至1.20美元之间)。

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(六)行权方式:批量行权。

(七)行权安排:自归属起始日起满12个月且公司完成上市后的次日起12个月内为期权激励计划上市后第一个行权期。本次期权行权尚需办理外汇管理部门备案和登记等事项,故实际行权时间根据实施批量行权相关事项办理情况确定。

(八)激励对象名单及行权情况:

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量	可行权数量	可行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	崔东	董事长、首席执行官	17,250,000	8,625,000	50.00%
2	李建文	董事、资深副总裁、首席运营官、核心技术人员	6,400,000	3,200,000	50.00%
3	林正忠	研发副总裁、核心技术人员	1,800,000	900,000	50.00%
4	吴畏	副总裁	2,116,667	1,058,333	50.00%
5	周燕	副总裁、董事会秘书	2,000,000	1,000,000	50.00%
6	吴继红	副总裁	2,000,000	1,000,000	50.00%
7	赵国红	副总裁、首席财务官	1,400,000	700,000	50.00%
8	沈月海	核心技术人员	1,086,720	543,360	50.00%
9	俞忠良	核心技术人员	1,200,000	600,000	50.00%
10	薛兴涛	核心技术人员	781,250	390,625	50.00%
11	佟大明	核心技术人员	900,000	450,000	50.00%
小计			36,934,637	18,467,318	50.00%
二、其他激励对象					
1	其他员工(568人)	其他员工(不含独立董事)	60,865,670	28,997,772	47.64%
小计			60,865,670	28,997,772	47.64%
总计			97,800,307	47,465,090	48.53%

注:

1.上表所列“已获授予的股票期权数量”不包含上市前已行权落地期权和经公司第一届董事会第十七次会议确认失效的期权。

2.上表所列的本期可行权数量以中登公司实际确认数为准。

3.授予对象本期可行权数量计算结果如出现不足1股的,尾数舍去取整。

4.上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系百分比结果四舍五入所致。

(九)激励对象行权后所获公司股票的转让限制

根据适用法律法规及上市后行权的期权激励计划,激励对象基于本次行权所获公司股票的转让限制如下:激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权之日起36个月内不得减持,同时上述锁定期届满后减持的,将比照适用法律法规对董事及高级管理人员的相关减持规定执行。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会对公司《期权激励计划》上市后第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查,发表核查意见如下:

本次拟行权的578名激励对象符合适用法律法规规定的激励对象条件,符合《期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司层面业绩考核结果达到考核目标,前述激励对象个人业绩考核结果达到考核目标,公司及前述激励对象未发生期权激励计划及执行条款规定的禁止事项。因此,前述激励对象的相关期权的上市后第一个行权期的行权条件已成就。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合行权条件的578名激励对象办理行权,对应可行权数量共47,465,090份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、行权日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据相关法律法规的规定确定行权窗口期,统一为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权及相关手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。参与期权激励计划的公司高级管理人员通过首次公开发行战略配售间接增持了部分公司股份的权益。除上述情形外,参与期权激励计划的高级管理人员在本次董事会决议日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

六、股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及相关规定:对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,应当采用期权定价模型等确认其公允价值。鉴于期权授予时公司股票未公开交易且不存在条款和条件相似的交易期权,故公司股票期权的公允价值采用二叉树期权定价模型计算确定。

公司聘请了银信资产评估有限公司和北京中企华资产评估有限责任公司对2015年至2024年期间授予的期权进行评估,其采取收益法评估确定公司权益价值,进一步采用权益分配模型评估计算出普通股价格,在此基础上通过使用二叉树期权定价模型计算得到对应期权在评估基准日的价值。

公司对换取员工服务的以权益结算的股份支付,以授予权益工具在授予日的公允价值计量股份支付费用,在等待期内每个资产负债表日对可行权权益工具数量作出最佳估计,计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

七、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为:本次失效及本次行权已取得现阶段必要的批准和授权;本次失效符合《管理办法》和上市后行权的期权激励计划的相关规定;本次行权的激励对象在上市后行权的期权激励计划项下所涉期权的第一个行权期行权条件已成就,符合《管理办法》和上市后行权的期权激励计划的相关规定;公司尚需就本次失效及本次行权的相关事宜及时履行信息披露义务;本次行权的激励对象尚需配合办理需经中国外汇管理部门审核的资金出境程序(如需)。

八、上网公告附件

(一)上海市锦天城律师事务所关于盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)《期权激励计划》部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就相关事宜的法律意见书;

(二)董事会薪酬与考核委员会关于《期权激励计划》上市后第一个行权期行权名单的核查意见。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:688820　证券简称:盛合晶微　公告编号:2026-018

盛合晶微半导体有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,盛合晶微半导体有限公司(以下简称“公司”)编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2026年3月3日出具的《关于同意盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕373号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票25,546.6162万股,发行价格为人民币19.68元/股,本次募集资金总额为人民币5,027,574,068.16元,扣除发行费用人民币248,973,009.21元(含增值税),实际募集资金净额为人民币4,778,601,058.95元。上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2026年4月15日出具《验资报告》(容诚验字[2026]230Z0052号)。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金使用和结余情况

报告期内,募集资金专项账户共用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)支出为人民币418,459.18万元。截至2026年6月30日,公司累计用于募投项目支出为人民币418,459.18万元,募集资金余额为人民币479,626.41万元。具体明细如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026年4月15日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额(注1)
一、募集资金总额	502,757.41
减:发行费用	24,897.30
二、募集资金净额	477,860.11
减:	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额(注2)	418,459.18
加:	
已完成置换审议尚未转出的预先投入募投项目的自筹资金(注3)	417,860.11
已完成置换审议尚未转出的以自筹资金支付的发行费用(注3)	2,043.20
尚未支付的发行费用	255.00
募集资金利息收入及扣减手续费等净额	67.17
三、报告期期末募集资金余额	479,626.41

注1:数据如有尾差系四舍五入所致,下同。

注2:其中包括(1)公司以自筹资金预先投入募投项目金额人民币417,860.11万元;(2)2026年1-6月募集资金专户直接支付的募投项目资金人民币599.07万元。

注3:公司于2026年5月29日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过募集资金置换相关议案,详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-009)。截至2026年6月30日,前述资金尚未从募集资金专户转出。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度与执行情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确的规定。报告期内,公司不存在违反相关法规文件的规定以及公司管理制度的情况。

(二)募集资金三方监管情况

公司、全资子公司盛合晶微半导体(江阴)有限公司分别于2026年3月、2026年6月与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日,上述监管协议履行正常。

(三)募集资金存储情况

截至2026年6月30日,首次公开发行股票募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2026年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2026年4月15日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
盛合晶微半导体有限公司(SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION)	中国建设银行股份有限公司江阴支行	NRA32050161613609888820	2,325.07	使用中
盛合晶微半导体(江阴)有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161613600004079	477,301.35	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年5月29日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币419,903.31万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中,拟使用募集资金人民币417,860.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金,拟使用募集资金人民币2,043.20万元置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2026年6月30日,前述资金尚未从募集资金专户转出。

公司于2026年5月29日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。截至2026年6月30日,公司尚未实施募集资金等额置换事项。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司未超募,不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

由于公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额低于《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金额,公司于2026年5月29日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行募集资金净额的实际情况,调整募投项目拟投入募集资金金额。具体调整情况如下:

单位:万元　币种:人民币

序号	募集资金投资项目	总投资额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	三维多芯片集成封装项目	840,000.00	400,000.00	398,216.75
2	超高密度互联三维多芯片集成封装项目	300,000.00	80,000.00	79,643.35
合　计		1,140,000.00	480,000.00	477,860.11

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会
2026年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2026年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2026年4月15日										
本年度投入募集资金总额			418,459.18										
已累计投入募集资金总额			418,459.18										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
三维多芯片集成封装项目	生产建设	否	400,000.00	398,216.75	398,216.75	338,815.83	338,815.83	-59,400.92	85.08	2025年12月	不适用	不适用	否
超高密度互联三维多芯片集成封装项目	生产建设	否	80,000.00	79,643.35	79,643.35	79,643.35	79,643.35	0.00	100.00	2026年12月	不适用	不适用	否
合计			480,000.00	477,860.11	477,860.11	418,459.18	418,459.18	-59,400.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)募集资金使用的其他情况”												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括(1)公司以自筹资金预先投入募投项目金额人民币417,860.11万元;(2)2026年1-6月募集资金专户直接支付的募投项目资金人民币599.07万元。

注2:三维多芯片集成封装项目已经基本完成项目规划产能建设,由于部分货款尚未到达付款时点,导致报告期末募集资金累计投入进度未达到100%。

注3:超高密度互联三维多芯片集成封装项目的募集资金已经使用完毕,后续总投资额超出募集资金的部分将通过自筹资金支付。

证券代码:688820　证券简称:盛合晶微　公告编号:2026-021

盛合晶微半导体有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年9月16日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@sjsemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

盛合晶微半导体有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月16日(星期三)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月16日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼首席执行官:崔东先生

副总裁兼董事会秘书:周燕女士

副总裁兼首席财务官:赵国红先生

独立董事:周忠惠先生、严勇先生、王国建先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月16日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月9日(星期三)至9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@sjsemi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0510-86975899

邮箱:IR@sjsemi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:688820　证券简称:盛合晶微　公告编号:2026-020

盛合晶微半导体有限公司
关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2026年半年度计提资产减值准备情况

盛合晶微半导体有限公司(以下简称“公司”)结合实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》及相关会计政策、会计估计的规定,为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日财务状况及2026年半年度经营成果,基于谨慎性原则,对截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提了减值准备。

2026年半年度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计16,586.25万元,具体如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	本期发生额	备注
信用减值损失	-52.04	含应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	-16,534.21	含存货跌价损失及合同履约成本减值损失
合计	-16,586.25	/

注:损失以“-”号填列,本期发生额以四舍五入的方式保留两位小数。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2026年半年度计提信用减值损失金额共计52.04万元。

(二)资产减值损失

公司资产减值损失为存货跌价